

上場企業研究セミナー 東京エレクトロン デバイス(株) 会社説明会

2010年3月25日

取締役執行役員専務 久我 宣之



®

東京エレクトロン デバイス株式会社

会社概要

当 社 概 要

設 立 : 1986年3月3日

事業内容 : 半導体、コンピュータ・ネットワーク機器等の専門商社

売 上 高 : 850億円(2010年3月期見込み)

本 社 : 横浜市神奈川区金港町1番地4横浜イーストスクエア

従 業 員 : 連結845名(2009年12月31日)

関連会社 : 東京エレクトロン デバイス上海

東京エレクトロン デバイス香港

東京エレクトロン デバイスシンガポール

パネトロン株式会社

国内営業拠点

全国展開 20拠点

2009年12月 つくばオフィス開設

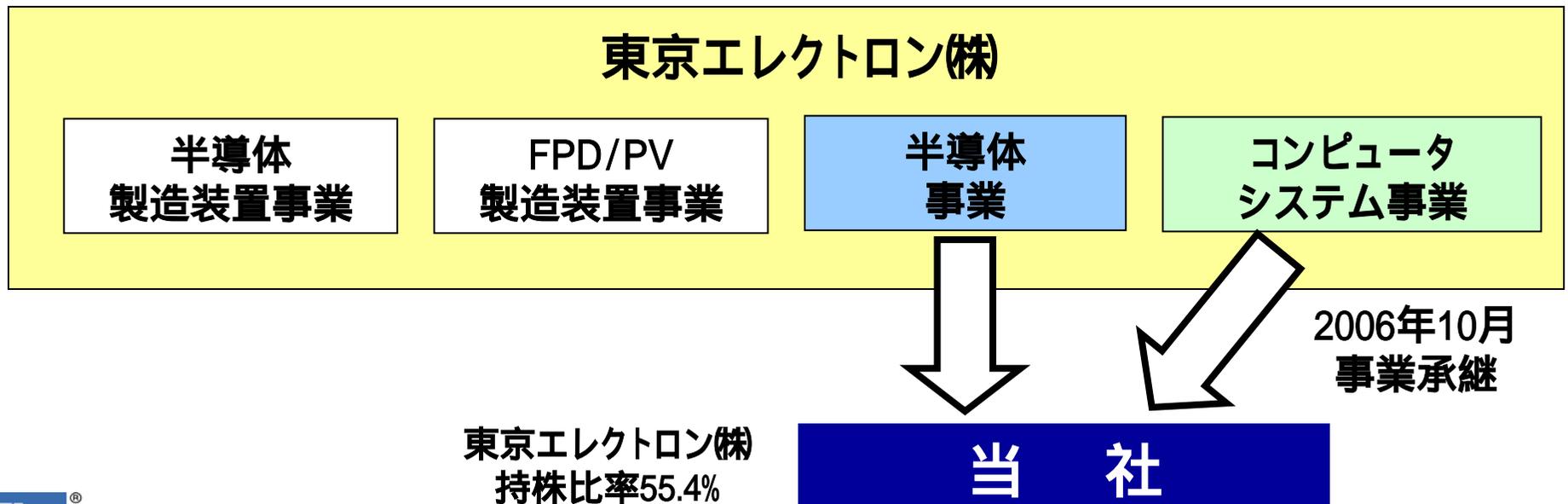
2010年 3月 姫路営業所、広島営業所
開設



当社沿革

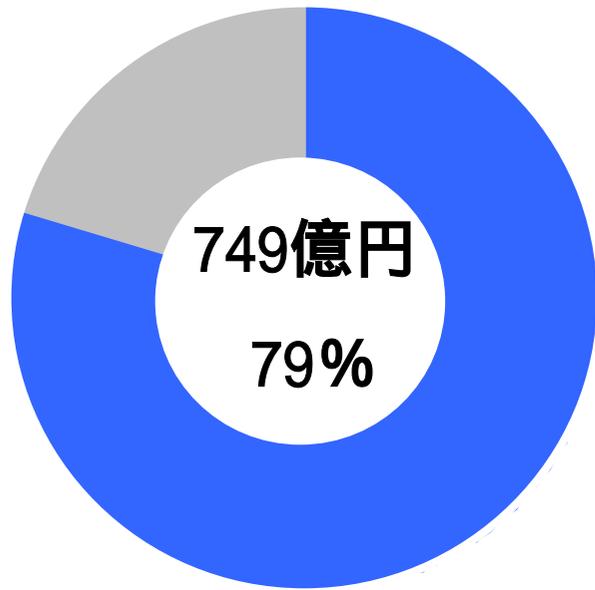
40年超の歴史と経験を有する専門商社

- ◆1965年 東京エレクトロン(株)の半導体事業部門でビジネスを開始
- ◆1998年 東京エレクトロン(株)の半導体事業が分離・独立
- ◆2003年3月7日 東証2部 上場
- ◆2006年10月 コンピュータシステム事業を承継

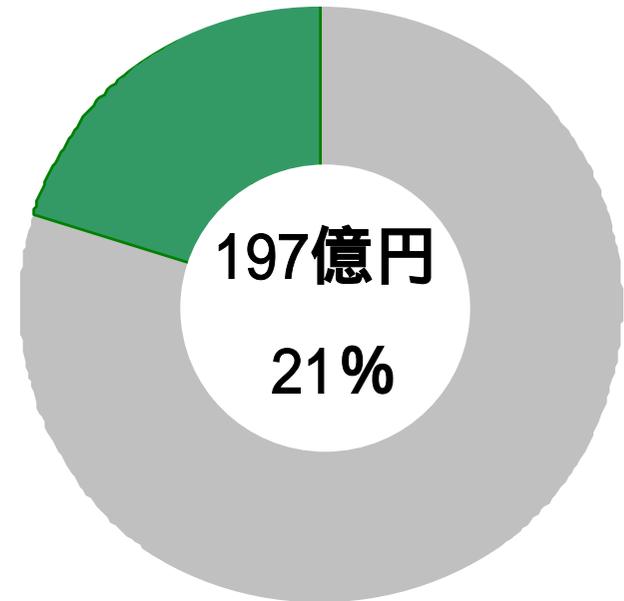


セグメント別売上高

< 2009年3月期売上高 : 947億円 >



半導体事業



コンピュータシステム事業

半導体事業の特徴

ビジネス形態



【特徴】

外国系有力メーカーを中心に約45社最先端商品をマーケティング

【特徴】

高付加価半導体を技術サポートとともに提供する技術商社

【特徴】

デジタルテレビ、PC、携帯電話、医療機器など幅広分野に満遍なく販売



仕入先

外国系有力メーカー中心に約45社

最先端商品をマーケティング

< 外国系35社 >

ザイリンクス 	プログラマブルロジックデバイス(PLD)半導体で50%以上のシェアを占めるNO.1企業
TI 	半導体メーカー売上高ランキング世界4位 デジタルシグナルプロセッサ(DSP)でNO.1企業
リニアテクノロジー 	高機能アナログIC分野で世界を代表する企業
フリースケール 	モトローラ社から分離独立。CPUの代表的企業

< 国内10社 >

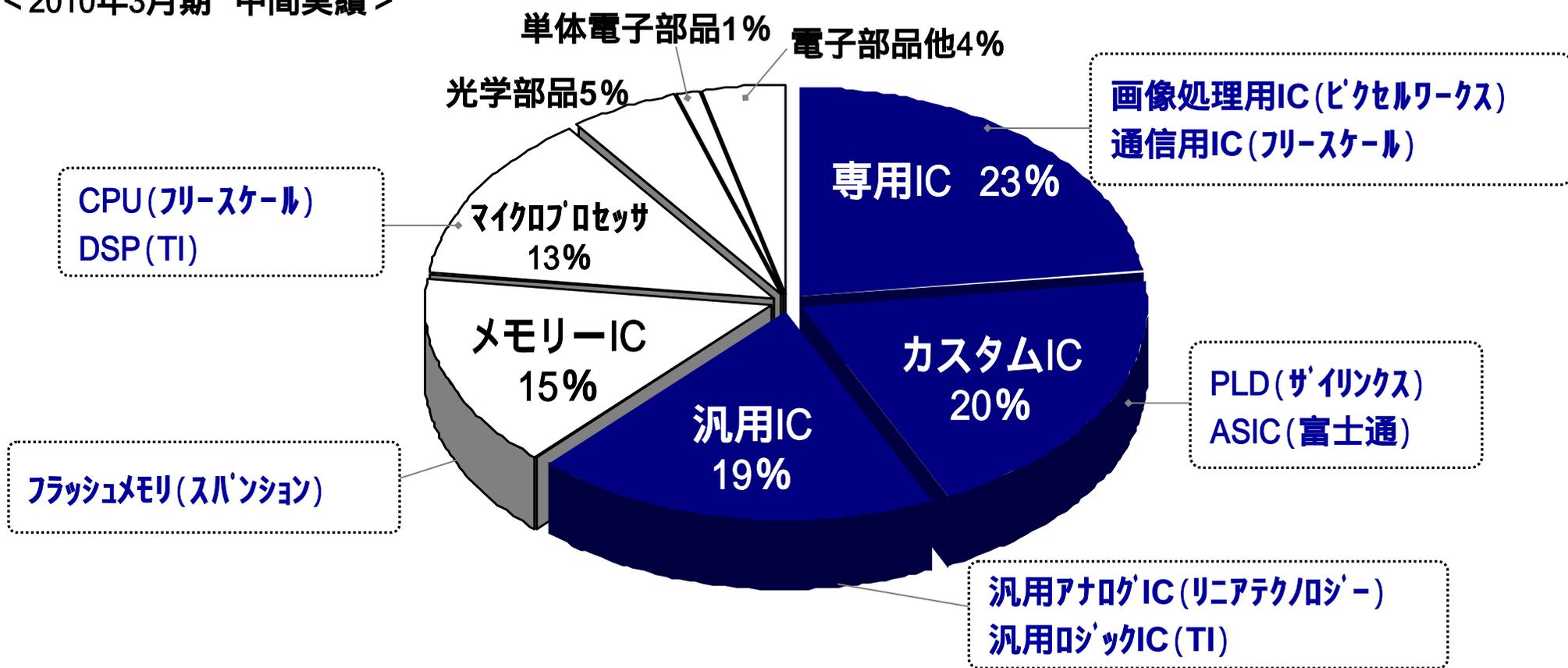
富士通、コーセルなど

注) 社名は敬称を省略し、略称で記載しております。

品目別売上構成

高付加価値半導体を中心とした商品構成
最先端商品を技術サポートとともに提供

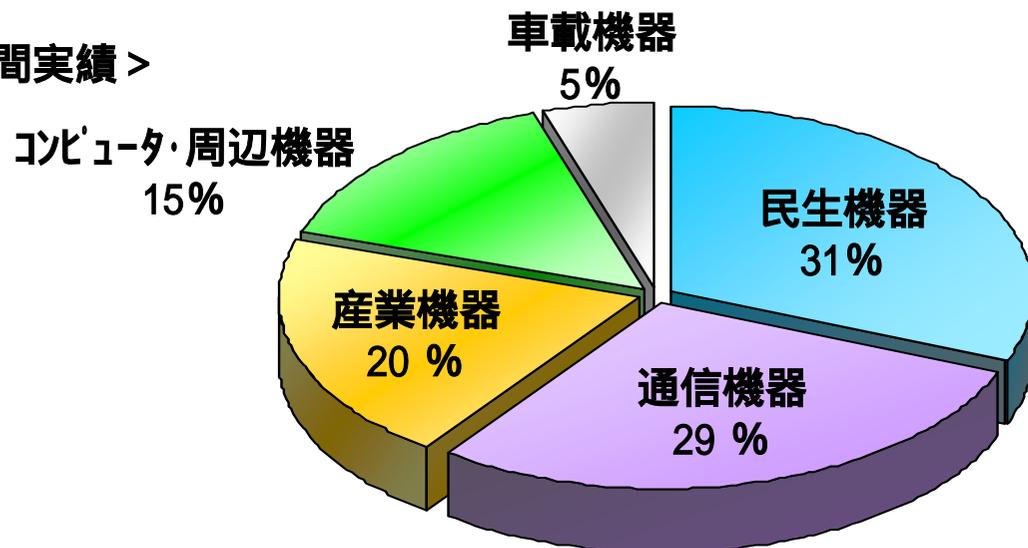
<2010年3月期 中間実績>



最終製品別 売上構成

最終製品は幅広い分野に

< 2010年3月期 中間実績 >



分野	主な最終製品	主なお客様
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	シャープ、ソニー、パナソニック他
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、基地局	パナソニック、日立、富士通他
産業機器	医療機器、放送機器、半導体製造装置、計測器	沖電気、東芝、パナソニック他
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	エプソン、東芝、パナソニック他
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	アイシン、パナソニック、三菱電機他

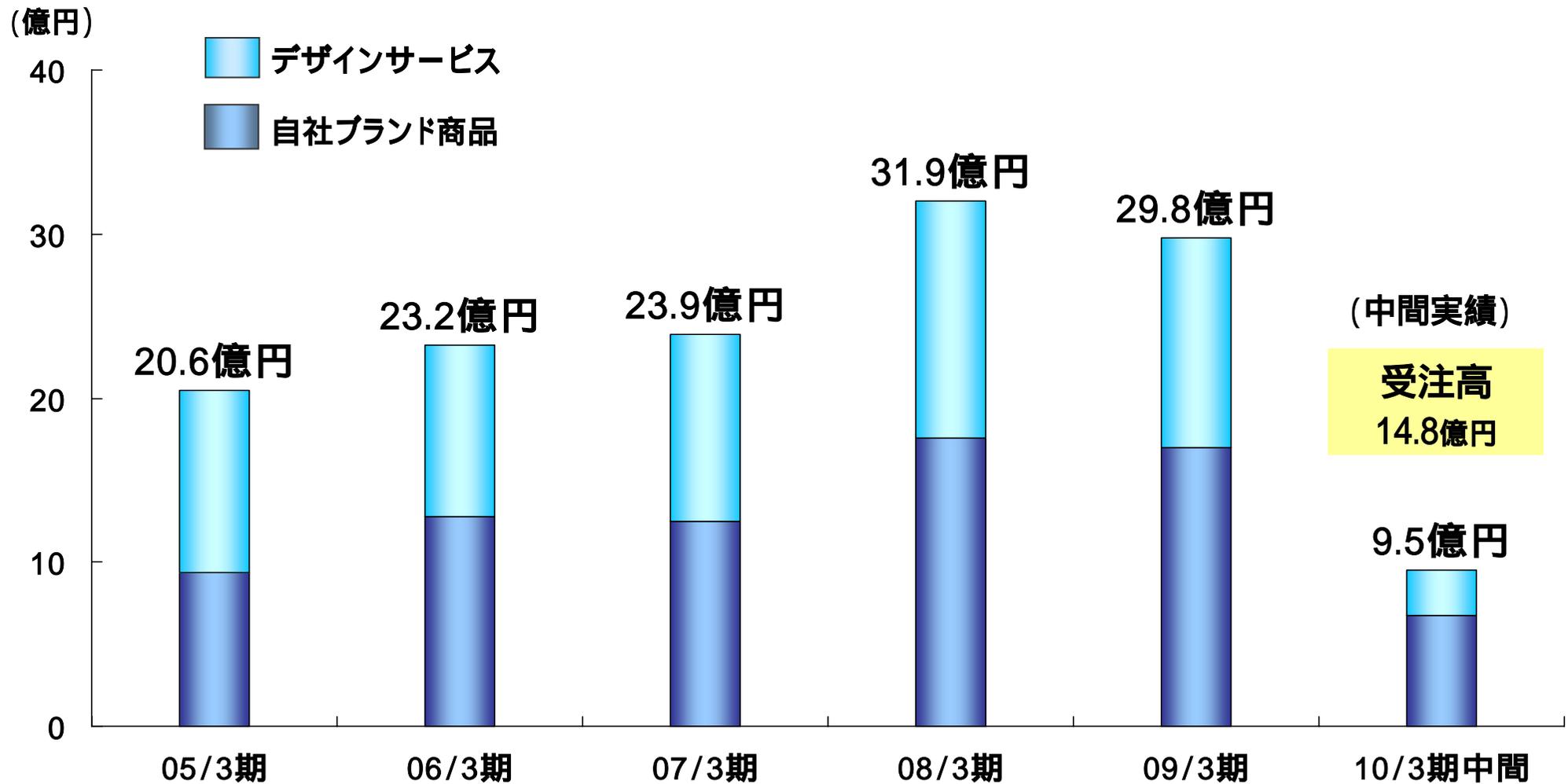
注) 社名は、敬称を省略し、略称を使用し、五十音順で記載させていただいております。

開発ビジネス

メーカー機能への取り組み



開発ビジネス 売上高推移



注)06/3期以降は、連結の数値を記載しております。

映像機器用LSI

- ・人の目で見ているような自然な映像を再現
- ・監視カメラ、車載カメラなどの映像機器向け
- ・海外への販売も予定



〈元画像〉



〈通常のガンマ補正〉

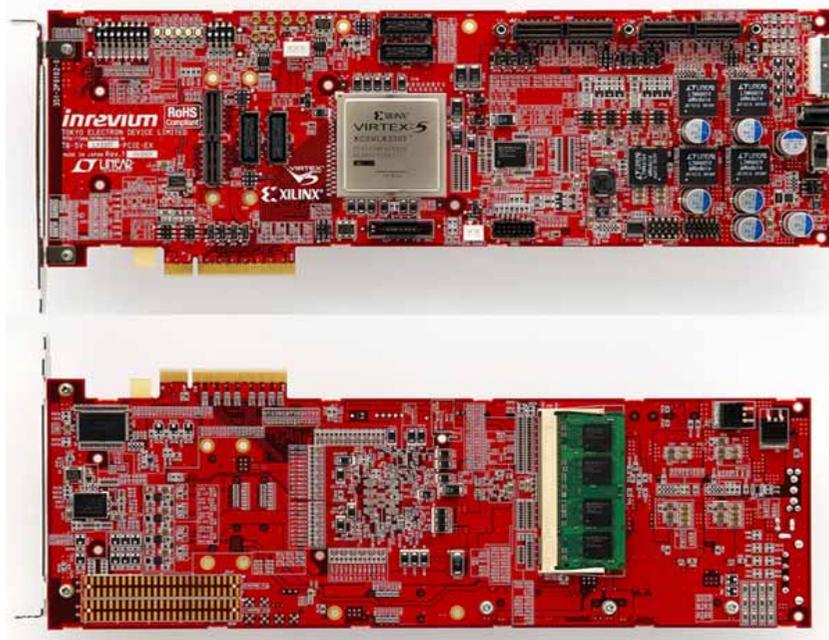
コントラストが消失



〈TE3610PF 使用時〉

LSI開発支援用評価ボード

- ・ザイリンクス社大規模FPGA (Virtex-5) 搭載
- ・LSI開発の期間短縮、費用削減に効果を発揮



< 主な応用分野 >
計測機器、医療機器などの
産業機器用LSI開発ツール

半導体事業 特徴 まとめ

外国系有力メーカーを中心に約45社の仕入先
最先端商品をマーケティング
高付加価値半導体を中心とした商品構成
最先端商品を技術サポートとともに提供
最終製品は幅広い分野に
メーカー機能を持つ技術商社

コンピュータシステム事業の特徴

ビジネス形態



【特徴】

ユニークで差別化が可能
最先端技術を探し出し
国内に投入
ネットワーク関連機器、
ストレージ関連機器、
ソフトウェアなど

【特徴】

製品販売で利益を
確保できる体制
技術的に難しい
複合システムを提供

【特徴】

ネットビジネス企業、
システム構築企業、
企業・官公庁の
コンピュータシステム
担当部署へ販売

仕入先

主に米国からユニークで差別化が可能な
最先端技術を探し出し、国内に投入

ネットワーク



97

00

05

10

ストレージ



ソフトウェア

Microsoft

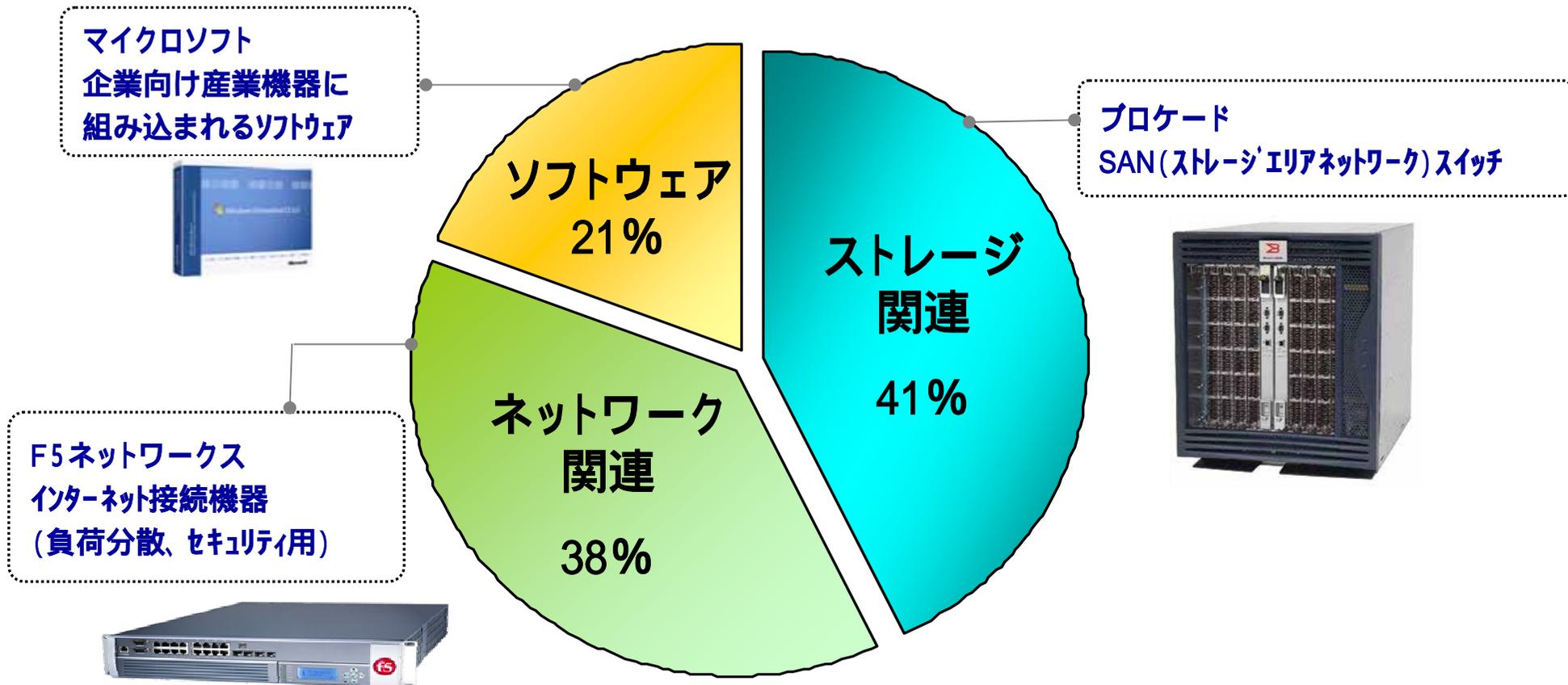
ORACLE

SENSAGE
Enterprise Security Analytics

品目別売上構成

参入したマーケットで 1 になる事が選定基準

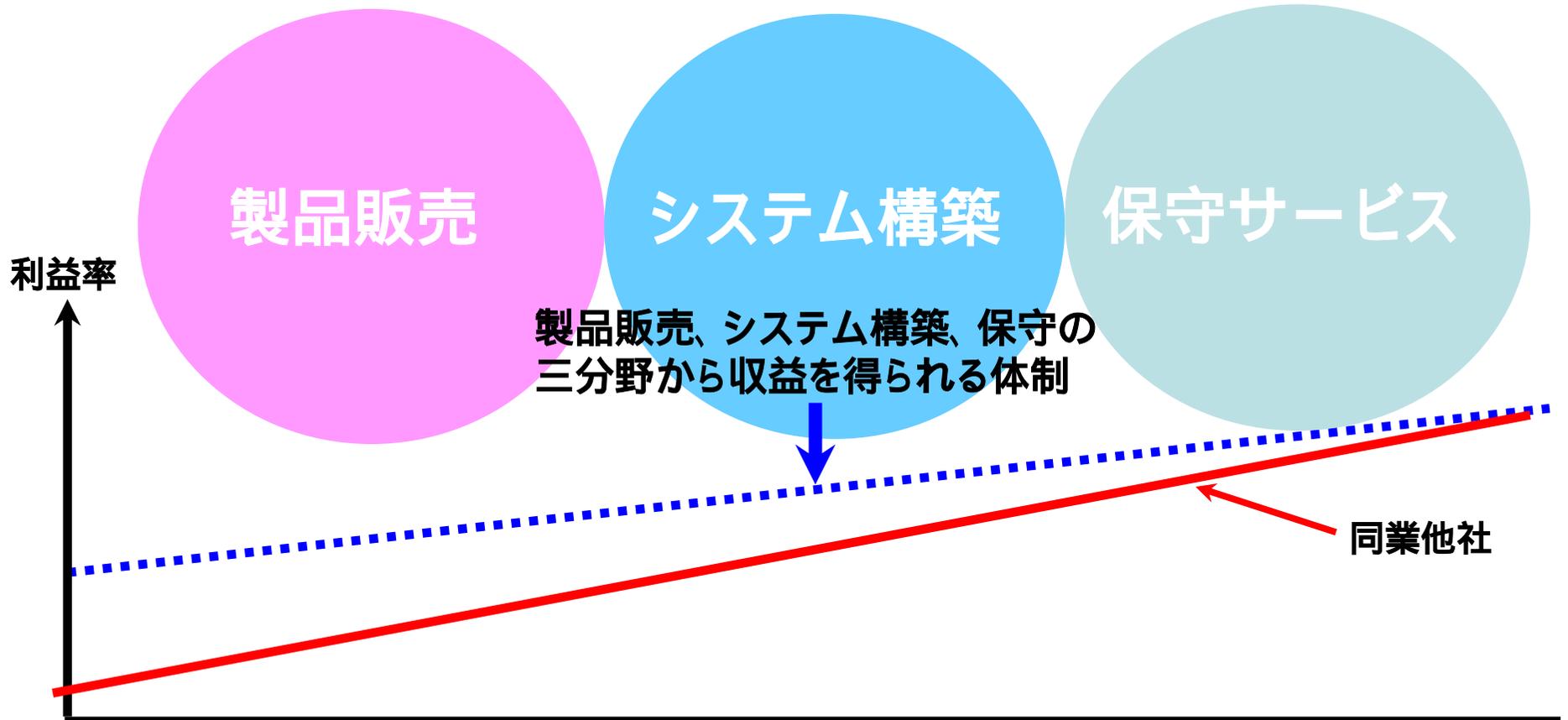
< 2010年3月期 中間実績 >



コンピュータシステム事業 概念図

製品販売で利益を確保できる体制

技術的に難しい複合システムを構築し提供



製品販売、システム構築、保守の三分野から収益を得られる体制

同業他社

* 図はイメージです。

コンピュータシステム事業 特徴 まとめ

主に米国からユニークで差別化が可能な
最先端技術を探し出し、国内に投入

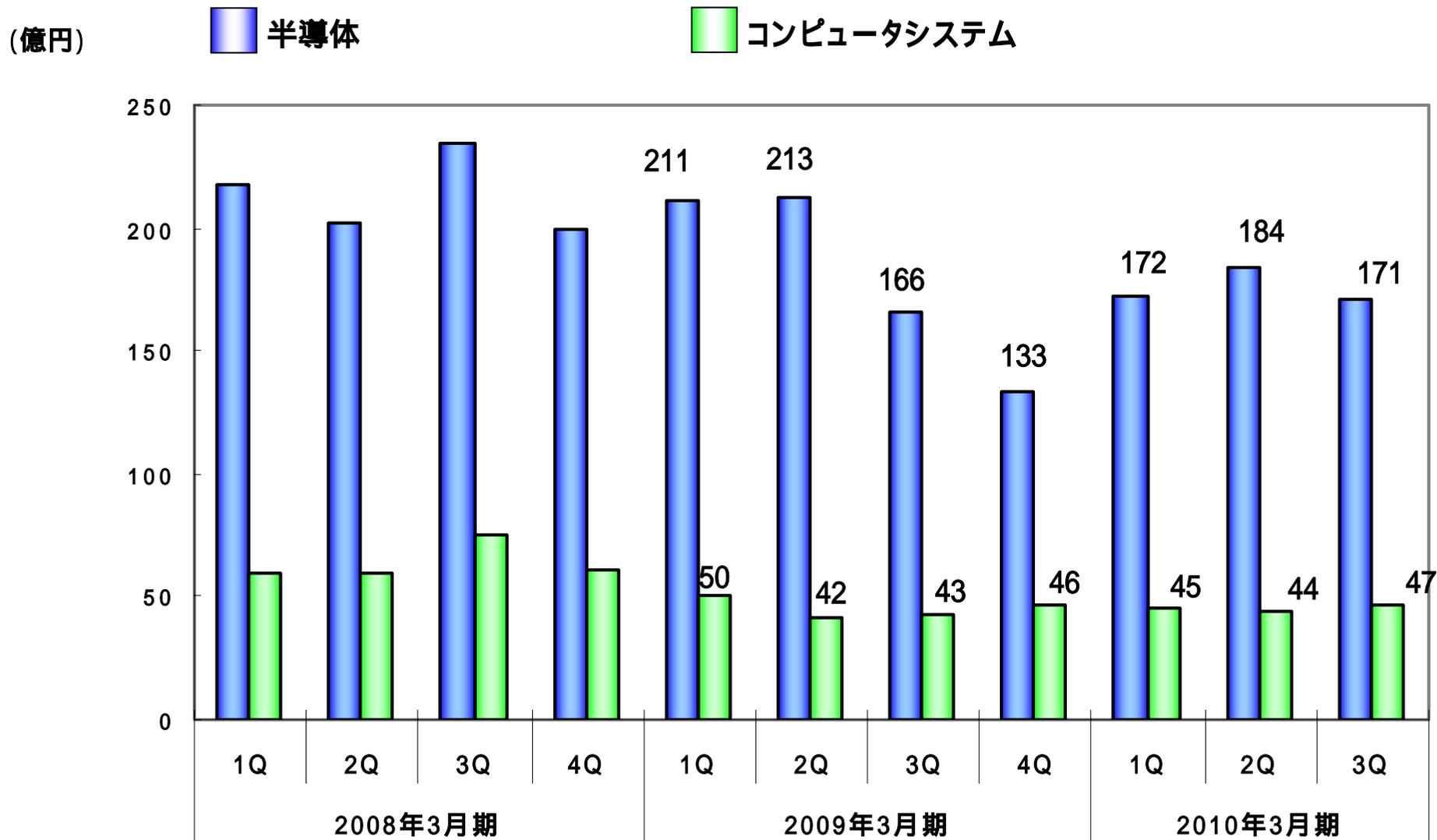
参入したマーケットで 1になる事が選定基準

製品販売で利益を確保できる体制

技術的に難しい複合システムを構築し提供

足元の業況及び 株主還元

当社を取りまく事業環境



当社を取りまく事業環境

< 半導体事業 >

- ・ 半導体市場は上期に在庫調整が終了
- ・ 民生機器は堅調に推移
- ・ 産業機器は回復傾向

< コンピュータシステム事業 >

- ・ データセンター等投資継続分野はあるが、引き続き国内IT市場はマイナス成長を想定
- ・ 製品販売は苦戦、保守サービスは堅調

2010年3月期 業績予想

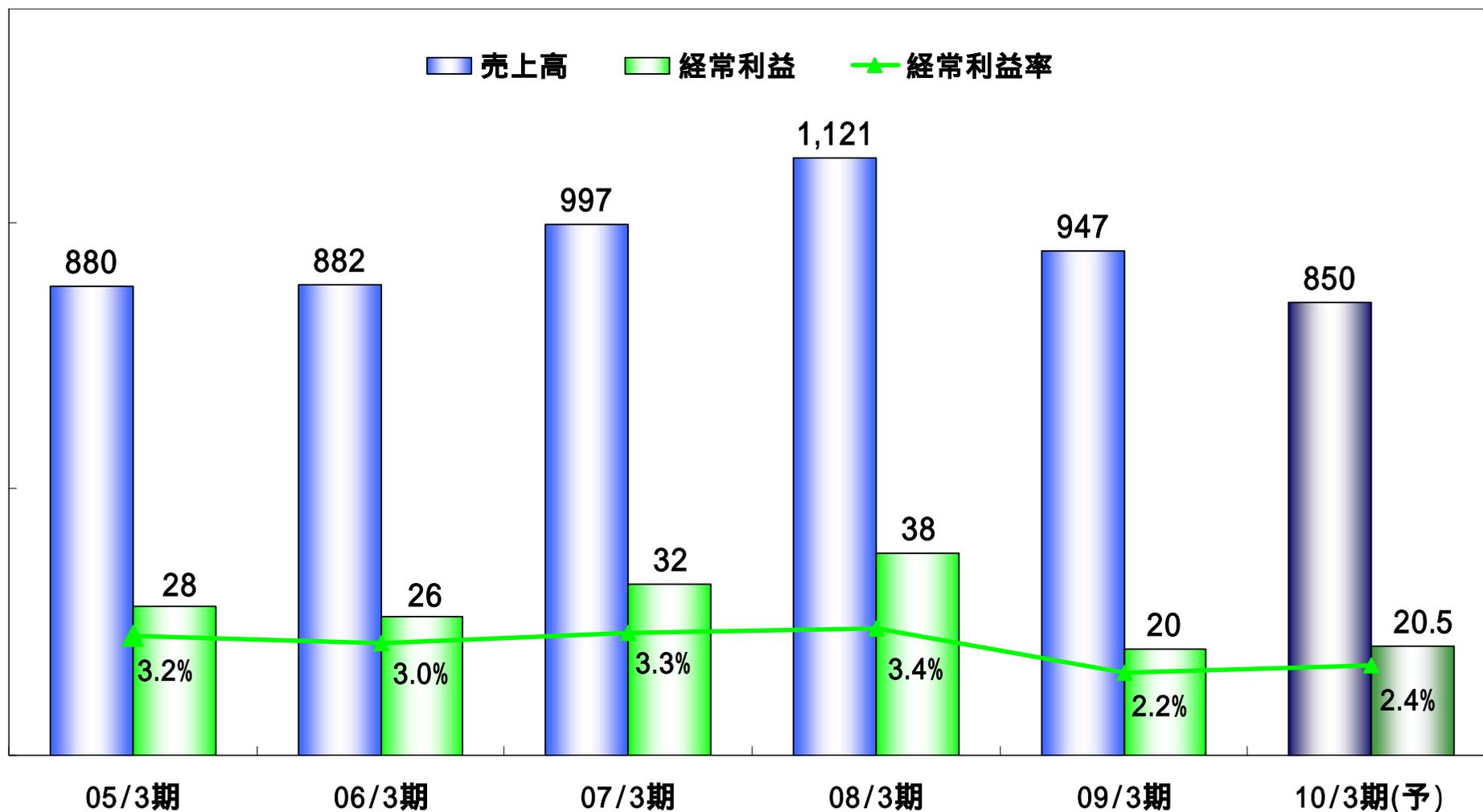
2010年3月23日発表

(単位:百万円)

	前期実績 2009/3期	前回発表 2009.10.29	今回発表	前回発表比較	
				増減額	増減率(%)
売上高	94,701	82,000	85,000	3,000	3.7
営業利益	1,840	1,480	2,000	520	35.1
経常利益	2,041	1,400	2,050	650	46.4
当期純利益	617	780	1,150	370	47.4

業績推移・計画

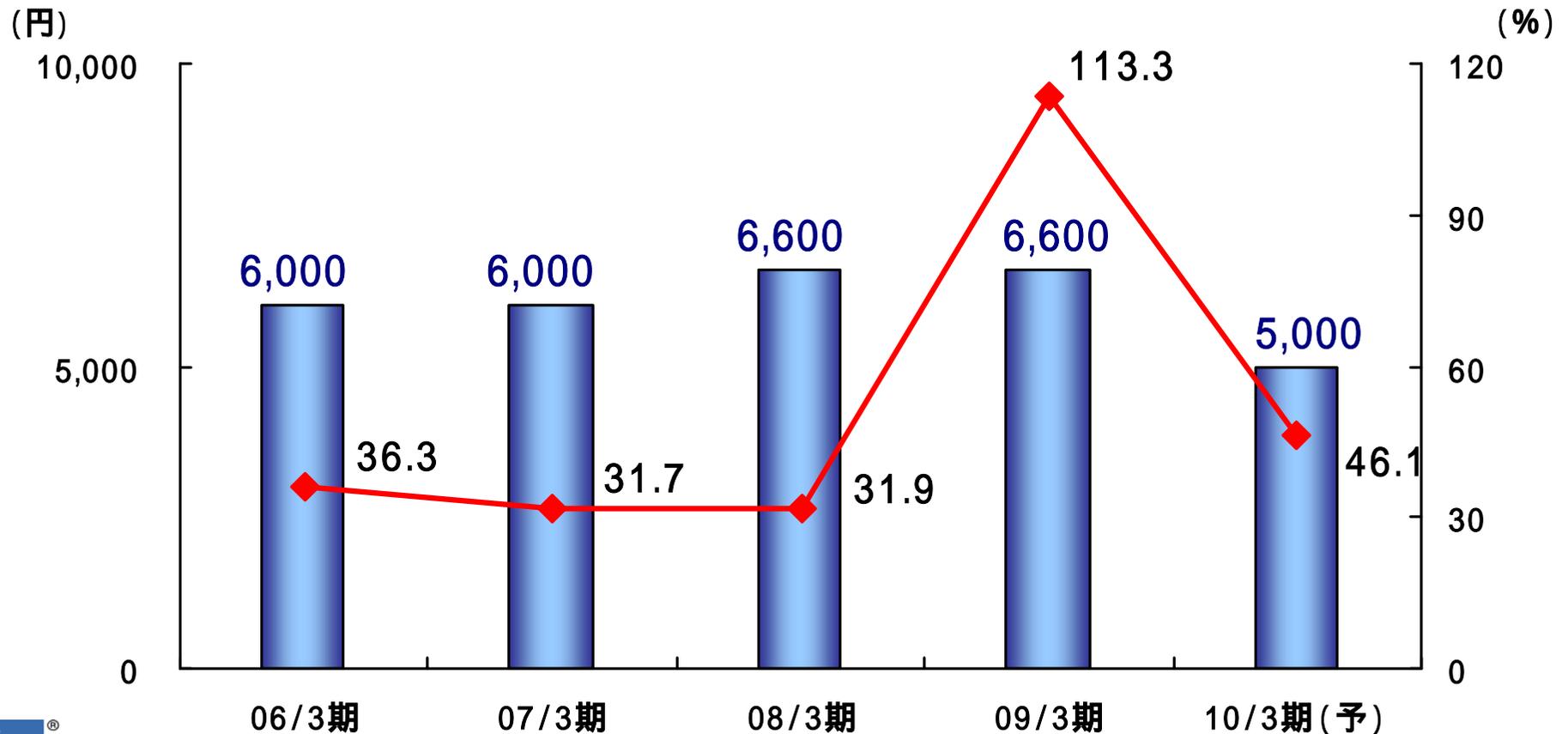
(単位:億円)



注)06/3期以降は、連結の数値を記載しております。

配当方針

- ・ 継続的かつ安定的な配当の実施
- ・ 業績連動型として連結配当性向30%目安



株式指標 (証券コード2760)

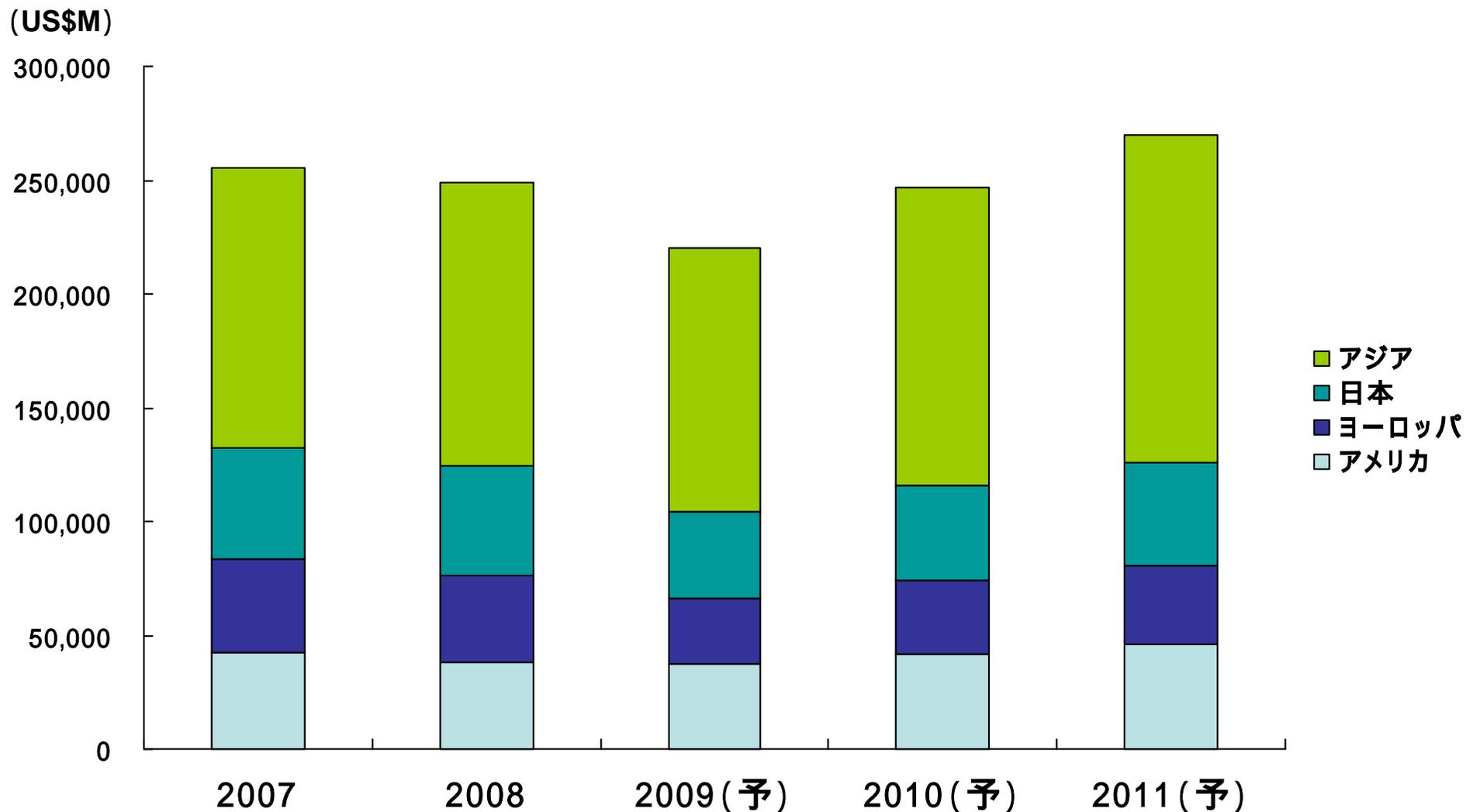
- ・ 1株当り配当金: 中間2,500円、期末2,500円 (2010年3月予定)
- ・ 配当利回り: 4% (3月15日株価終値126,000円で計算)
- ・ 予想PER: 11.6倍 ・ PBR0.6倍



(C)QUICK Corp.

成長戦略

半導体市場予測

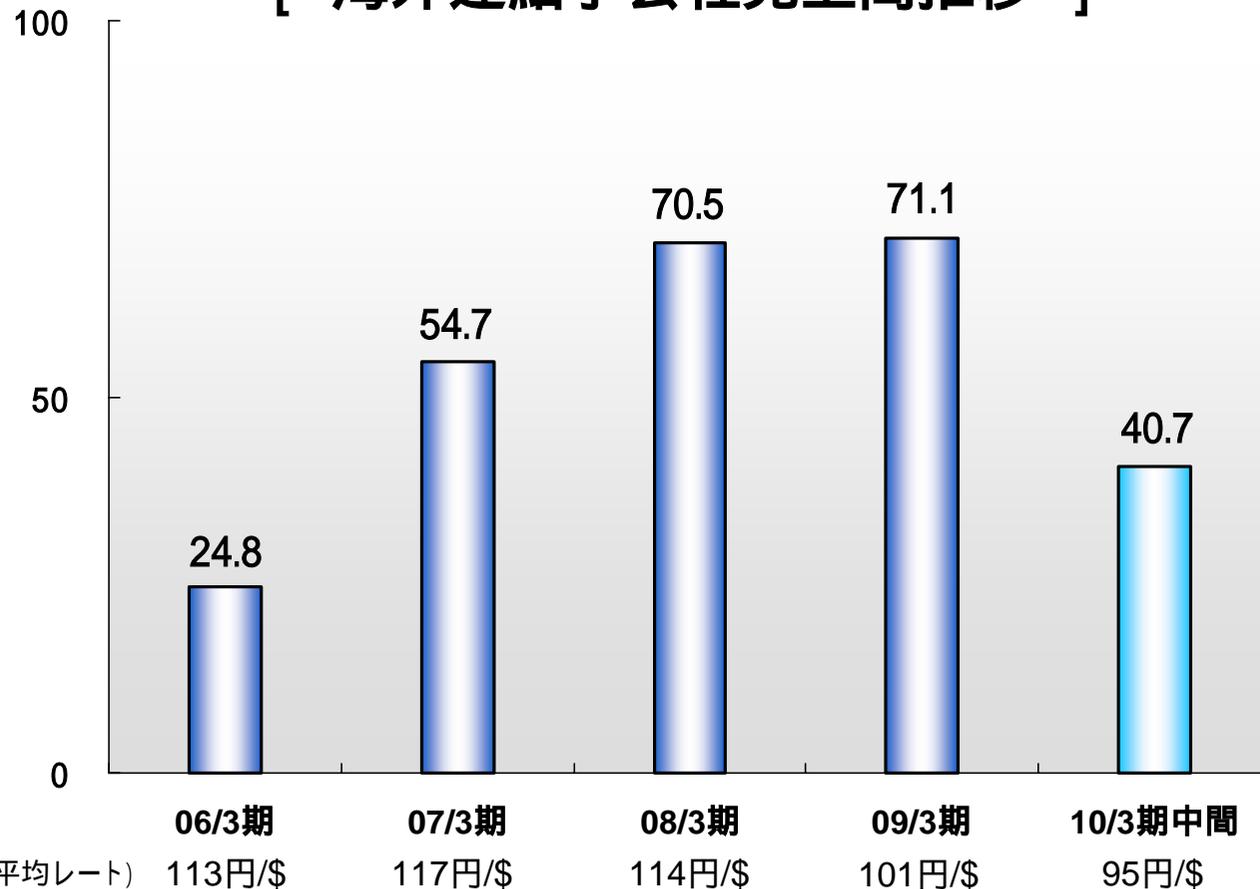


出典)WSTS 2010年秋季半導体市場予測

成長戦略

1. 半導体事業(商社ビジネス) 海外展開

(US\$M) [海外連結子会社売上高推移]



[営業拠点]



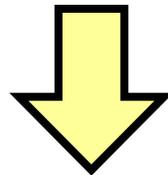
成長戦略

1. 半導体事業(商社ビジネス) 海外展開

有望マーケットであるアジア地域での拡販

営業拠点の拡充

現地企業への営業強化



売上拡大の源泉

目標: 半導体事業売上高の20%

成長戦略

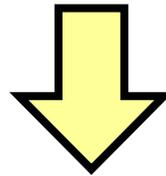
2. 半導体事業(商社ビジネス) 国内展開

新規顧客獲得

拠点拡充による地域密着営業の一層推進
産業機器分野(医療、環境など)に注力

商権拡大

技術サポートの充実により既存顧客を深耕



安定成長の源泉

当社ビジネスの根幹

目標: 半導体市場予測プラス の成長

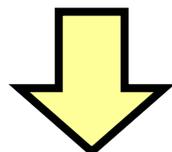
成長戦略

3. 半導体事業(開発ビジネス)

設計受託業務、OEM販売の推進
量産供給及び品質体制の強化
トップセールスによる顧客拡大

自社ブランド商品の拡販

セキュリティ関連向け商品群の拡充
アジア地域への販売推進



利益成長の源泉

目標:売上高50億円

成長戦略

4. コンピュータシステム事業

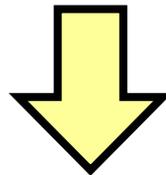
お客様に密着した提案営業を強化

製品別営業からお客様別営業に組織改編

全国20箇所の営業拠点を活用

需要が高まるデータセンター向けビジネスに注力

システム構築、製品販売、保守のトータル提案



利益成長の源泉

目標: コンピュータシステム事業で

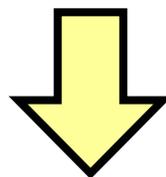
営業利益率10%以上

5. 新規事業

環境エネルギー等成長分野への進出

LED、電池などを来期から取り扱い予定

組み込み機器向け省電力製品を販売予定



事業拡大の源泉

**上場後最高経常利益
38億円(2008年3月期)
の早期更新を実現**

お客様 仕入先から信頼される

NO.1 技術商社を目指してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

本日はご清聴ありがとうございました。



品目別仕入先名

セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス 事業	専用IC	加'ウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ'社、フリースケール・セミコンダ'クタ社、富士通エレクトロニクス(株)、インターシル社、ビクセルワークス社、シリコンイメージ'社、ビクシシステムズ'社、ザ'リンク・セミコンダ'クター社、インビ'アム
	カスタムIC	富士通エレクトロニクス(株)、ザ'リンクス社、インビ'アム
	汎用IC	リニアテクノロジー'社、オン・セミコンダ'クター社、TI 社
	メモリIC	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、スパンション社
	CPU	フリースケール・セミコンダ'クタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI 社
	光学部品	アバ'ゴ・テクノロジー'社
	個別素子	オン・セミコンダ'クター社
	電子部品他	コーセル(株)、インビ'アム
コンピュータシステム 関連事業	ストレ'ジ関連	ブ'ロケード社、エミュレックス社
	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセ'ージ社

用語説明(1)

品目	主な取扱商品	機能
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
メモリIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトブラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ボード)

ストレージ関連



SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、
SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。

ネットワーク関連



インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)
企業向けネットワークシステム構築機器。

ソフトウェア



セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア
企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社
のソフトウェア。

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。